

证券代码：688216

证券简称：气派科技



气派科技股份有限公司
2026 年度以简易程序向特定对象
发行股票预案

二〇二六年四月

声 明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。

三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本次以简易程序向特定对象发行股票事宜已经公司 2025 年年度股东会授权公司董事会实施，并经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

二、本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35 名（含 35 名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

三、本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或资本公积转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N 。

本次发行的最终发行价格将根据股东会授权，以竞价方式确定发行价格，并由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定，但不低于前述发行底价。

四、本次发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的 30%。在前述范围内，最终发行数量由股东会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。

五、本次发行股票募集资金总额 11,000.00 万元（含本数），不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资额
1	高密度高性能芯片封测项目	19,812.39	11,000.00
合计		19,812.39	11,000.00

本次发行股票募集资金全部用于公司“高密度高性能芯片封测项目”建设。在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

六、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起六个月内不得转让。因公司送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

七、公司在本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按

发行后的持股比例共同享有。

八、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的要求，公司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。关于公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、未分配利润使用安排情况，请参见本预案“第五节 利润分配政策及执行情况”。

九、公司提醒投资者关注：本次发行将面临摊薄即期回报的风险。本次发行后公司的净资产和股本将相应增加，由于募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间的项目建设周期，项目产生效益尚需一定的时间。因此，公司净资产收益率和每股收益存在短期内出现下滑情况的可能，未来随着募投项目效益逐步体现，公司的每股收益和净资产收益率将逐步回升。为保障中小投资者的利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施，详见“第六节 本次以简易程序发行股票摊薄即期回报分析”。

特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险，公司为应对即期回报被摊薄风险所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

十、公司本次以简易程序向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规的有关规定，本次以简易程序向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

十一、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 本次股票发行相关的风险说明”的有关内容，注意相关风险。

目 录

特别提示	3
目 录	6
释 义	7
第一节 本次发行股票方案概要	10
一、发行人基本情况	10
二、本次发行的背景和目的	10
三、发行对象及其与公司的关系	14
四、本次发行股票方案概要	14
五、本次发行是否构成关联交易	17
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	17
七、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件	18
八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	18
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	19
一、本次募集资金的使用计划	19
二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	19
三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响	25
四、总结	25
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	27
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况	27
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	28
三、本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	28
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	29
五、本次发行对公司负债情况的影响	29
第四节 本次股票发行相关的风险说明	30
第五节 利润分配政策及执行情况	35
一、公司利润分配政策	35
二、公司近三年股利分配情况	37
三、公司未来三年股东分红回报规划	38
第六节 本次以简易程序发行股票摊薄即期回报分析	42
一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	42
二、对于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示	44
三、本次发行的必要性和合理性	44
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	45
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	47
六、公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺	48

释 义

本发行预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、发行人、气派科技	指	气派科技股份有限公司
本次发行	指	气派科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的行为
广东气派	指	广东气派科技有限公司
气派芯竞	指	气派芯竞科技有限公司
气派谋远	指	东莞市气派谋远股权投资合伙企业（有限合伙）
惠州气派	指	惠州气派科技有限公司
股东会	指	气派科技股份有限公司股东会
董事会	指	气派科技股份有限公司董事会
审计委员会	指	气派科技股份有限公司董事会审计委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
报告期	指	2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-3 月
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日、2026 年 3 月 31 日
预案、本预案	指	气派科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案
集成电路/芯片/IC	指	按照特定电路设计，通过特定的集成电路加工工艺，将电路中所需的晶体管、电感、电阻和电容等元件集成于一小块半导体（如硅、锗等）晶片或介质基片上的具有所需电路功能的微型结构
功率半导体	指	支持高电压、大电流转换的半导体器件，可完成电子装置中电压和频率、直流交流的转换
晶圆	指	又称 Wafer、圆片，指硅衬底的且在上面重复排布具有完整电性能的集成电路或者晶体管的晶圆，尺寸有 4 吋、5 吋、6 吋、8 吋、12 吋等
封装	指	对通过测试的晶圆进行减薄、划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到具有独立具有完整功能的集成电路的过程。保护电路芯片免受周围环境的影响（包括物理、化学的影响），起到保护芯片、增强导热（散热）性能、实现电气和物理连接、功率分配、信号分配，以连接芯片内部与外部电路的作用

CPC	指	一种由气派科技自主定义的表面贴片式封装形式
SOP	指	Small Outline Package 的缩写，小外形封装，表面贴装型封装之一，引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L 字形）
SOT	指	Small Outline Transistor 的缩写，小外形晶体管贴片封装，随着集成电路集成度的提高，现在多用于封装集成电路，是表面贴装型封装之一，一般引脚小于等于 8 个的小外形晶体管、集成电路
LQFP	指	Low-profile Quad Flat Package 的缩写，薄型四边引线扁平封装，塑封体厚度为 1.4mm
QFN	指	Quad Flat No-lead Package 的缩写，即方形扁平无引脚封装，表面贴装型封装之一，封装四侧配置有电极触点，由于无引脚，贴装占有面积比 QFP 小，高度比 QFP 低
DFN	指	Dual Flat No-lead Package 的缩写，双边扁平无引脚封装，DFN 的设计和应用与 QFN 类似，都常见于需要高导热能力但只需要低引脚数的应用。DFN 和 QFN 的主要差异在于引脚只排列在产品下方的两侧而不是四周
Qipai	指	由气派科技自主定义的双排直插式的封装形式
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，微机电系统，是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源、微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统
FC	指	FC 是 Flip Chip 的缩写，倒装芯片封装工艺，在芯片上制作凸点，然后翻转芯片用回流焊等方式使凸点和 PCB、引线框等衬底相连接，电性能和热性能比较好，封装体可以做的比较小
QFN	指	Quad Flat No-lead Package 的缩写，即方形扁平无引脚封装，表面贴装型封装之一，封装四侧配置有电极触点，由于无引脚，贴装占有面积比 QFP 小，高度比 QFP 低
DFN	指	Dual Flat No-lead Package 的缩写，双边扁平无引脚封装，DFN 的设计和应用与 QFN 类似，都常见于需要高导热能力但只需要低引脚数的应用。DFN 和 QFN 的主要差异在于引脚只排列在产品下方的两侧而不是四周
TO	指	Transistor Out-line Package 的缩写，即晶体管外形封装，是一种直插式的封装形式
DIP	指	Dual in line-pin Package 的缩写，也叫双列直插式封装技术，采用双列直插形式封装的集成电路
CPC	指	由气派科技自主定义的表面贴片式封装形式
CDFN/CQFN	指	由气派科技自主创新且定义的封装系列，区别 SOP 和 QFN/DFN，在保证散热的情况下，既能使用回流焊焊接，也可以波峰焊焊接，是小体积的贴片式系列封装形式
PDFN	指	Passive-Down-Flux-on-Noodle, 紧凑型表面贴装器件封装，采用塑封封装材料，无引脚设计，具有两面金属连接区域，适用于高密度集成电路

氮化镓/GaN	指	Gallium Nitride，氮和镓的化合物，一种第三代半导体材料，具有高击穿电压、高电流密度、电子饱和漂移速度高等特点，主要应用在 5G 通讯、半导体显示、电力电子器件、激光器和探测器等领域
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	气派科技股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节 本次发行股票方案概要

一、 发行人基本情况

中文名称	气派科技股份有限公司
英文名称	China Chippacking Technology Co.,Ltd.
法定代表人	梁大钟
有限公司成立日期	2006年11月7日
股份公司成立日期	2013年6月6日
注册资本	106,879,805元
统一社会信用代码	914403007954196722
电话	0769-89886666
传真	0769-89886013
电子信箱	IR@chippacking.com
邮政编码	523330
公司网址	www.chippacking.com
上市日期	2021年6月23日
股票上市地	上海证券交易所科创板
公司股票简称	气派科技
股票代码	688216
经营范围	一般经营项目是：集成电路的研发、测试封装、设计、销售（不含蚀刻等有工业废水产生的工艺及其他限制项目），货物进出口、技术进出口；设备租赁（不含融资租赁）（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

注：公司于 2026 年 2 月 12 日完成 2025 年向特定对象发行股份事项，股本总额由 10,687.9805 万元变更为 11,447.9805 万元，截止目前，尚未完成工商变更登记。

二、 本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家行业规划及产业政策的大力支持

半导体产业是支撑国民经济发展与国防安全的战略性、基础性、先导性产业，直接关乎国家产业链供应链自主可控与核心竞争力。在全球科技竞争日趋激烈的

大背景下，我国陆续出台一系列扶持政策，从研发投入、税收优惠、人才引育、产业链协同等多维度给予全方位支持，引导产业高质量发展，全力鼓励突破核心技术瓶颈，摆脱高端芯片及配套环节对外依赖的局面。

2026 年 3 月，全国两会发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，提出加强原始创新和关键核心技术攻关，完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。2025 年 3 月，国家发展改革委、工业和信息化部等多部门发布的《关于做好 2025 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》提出，延续并优化集成电路产业税收优惠政策。2024 年 5 月，中央网信办等三部门联合发布的《信息化标准建设行动计划（2024—2027 年）》提出，围绕集成电路关键领域，加大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标准攻关，推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制。

2、半导体行业景气度全面复苏与国产替代驱动半导体封测市场发展

半导体行业呈现“强周期性”，每 3-5 年经历一轮“需求爆发-产能扩张-库存调整-复苏”的循环。历经行业周期调整后，全球半导体行业迎来全面复苏拐点，下游终端市场需求持续回暖，存储芯片、逻辑芯片、功率器件等核心产品出货量稳步攀升，上游设计与制造环节产能持续释放，直接带动后端封装测试需求快速增长，行业景气度持续上行。从全球市场来看，半导体厂商纷纷扩大资本开支，新增产能逐步落地，封测环节产能利用率持续提升，部分先进封测产能甚至出现供需偏紧态势，行业整体营收与利润规模同步回暖，为封测产业发展营造了良好的市场环境。

随着全球贸易摩擦和技术封锁加剧，我国半导体产业的部分关键核心技术领域仍面临“卡脖子”困境，对外依存度较高。近年来我国大力推动半导体产业链自主可控，国产替代已从“可选项”变为“必选项”。在政策引导与市场需求双重推动下，本土封测企业技术突破步伐加快，封装测试领域国产化率持续提升。在半导体行业景气度全面复苏与国产替代的驱动下，我国半导体封测产业将迎来良好的发展机遇期。

3、新兴应用领域为半导体封装测试产业发展注入了新的增长动力

集成电路作为各类电子设备的核心部件，下游应用场景持续拓宽，传统消费电子、电力电子、通信设备、医疗电子、航空航天等领域需求保持波动增长趋势。而物联网、人工智能、云计算、大数据、5G 通信、工业机器人、新能源汽车等新兴应用领域的蓬勃发展，进一步催生了高性能、低功耗、小型化、高集成度的芯片需求，为集成电路产业注入了强劲的新增长动能。

封装测试是半导体产业链的核心关键环节，承担着芯片电路连接、结构保护、性能优化及功能验证的重要作用，直接影响集成电路产品的可靠性、稳定性与实际应用效能，是芯片从晶圆走向终端应用的重要环节，其技术水平与产业规模直接关联集成电路产业的整体竞争力。集成电路产业的整体迭代升级、技术突破以及应用领域的不断拓宽，也会反向推动封测产业同步革新，推动封测产业的进一步发展。

4、本次发行符合公司发展战略

公司一直致力于半导体封装测试相关技术的研发创新并不断加强研发投入，掌握了多项核心技术。公司将根据行业未来发展趋势及技术发展方向，加强对新兴领域的研发投入，持续对功率半导体和先进封装方面投入研发，开发更多品类功率半导体封装和先进封装技术，为公司产品丰富提供有力的技术支撑。

本次发行股票有助于提升公司 QFN/DFN、FC-QFN/DFN、LQFP 等中高端产品产能，从而有助于抓住市场机遇，在满足市场需求快速增长的同时，提升上市公司盈利能力。

（二）本次发行的目的

1、突破产能瓶颈，满足下游市场需求

半导体封装测试行业在技术进步、下游应用领域不断拓展以及国产替代等多因素驱动下，迎来良好的发展机遇期。其一，半导体产品在集成度、性能、功耗及可靠性等方面的要求持续提升，对封装测试环节的精度控制、工艺复杂度与规模化生产能力提出更高标准。其二，人工智能、汽车电子、高性能计算、物联网等新兴应用场景快速崛起，带动高可靠性、高定制化封装测试产品的需求持续增

长。其三，随着国产半导体产业替代进程加速，本土封装测试企业迎来重要发展契机。

公司深耕半导体封装测试领域多年，已发展成为华南地区规模领先的内资封装测试企业之一。近年来，公司业务规模稳步扩张，产能利用率持续攀升。2023年至2025年，公司封装测试产能利用率分别为68.13%、80.57%、88.52%，2025年全年处于较高负荷运行状态。现有产能接近饱和已成为制约订单承接与业务扩张的重要因素。若无法及时扩充产能，公司将面临订单交付延迟、客户流失等风险，错失行业发展机遇，进而影响营收规模扩大与市场份额提升。本次扩产项目通过新增封装测试产能，可有效释放产能瓶颈，满足下游市场需求，提升公司可持续发展能力。

2、扩大经营规模，巩固和提升行业竞争地位

当前，国内封装测试市场竞争格局日趋激烈，长电科技、通富微电、华天科技等内资领先企业不仅通过资本市场募集资金扩充产能、进行技术和产品升级，还通过市场化收购兼并实现资源整合与跨越式发展，不断筑牢竞争优势。与此同时，各类外资及合资封测企业也持续加大在中国大陆的产能布局与资金投入，进一步加剧了国内市场的竞争烈度，行业头部集聚效应愈发明显。

公司经过在封测领域多年的积累和拓展，目前已具备一定规模和较强技术实力，但与长电科技、通富微电和华天科技等为典型代表的中国大陆封装测试行业龙头企业相比，仍有较大的提升空间。在当前市场高速发展的态势下，公司如若不能及时扩大自身规模、增强竞争实力，将可能面临市场份额被挤压、客户资源流失的风险。特别是随着下游客户对供应链稳定性和交付能力的要求不断提高，产能规模已成为客户选择封测供应商的重要考量因素。因此，通过本项目建设扩大生产规模，是公司巩固和提升市场竞争地位的必然选择。

3、优化产品结构，提高先进封装产品占比

近年来，集成电路终端系统向多任务处理、微型化方向加速演进，持续驱动封装技术向高性能、高密度、高散热、晶圆级、薄型化及小型化迭代升级。在此

背景下，FC、SiP、TSV 等先进封装技术的应用场景不断拓展，已成为行业重要发展方向。

当前，日月光、安靠、长电科技、华天科技、通富微电等国内外领先企业均已较全面地掌握 FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV、Chiplet 等先进封装技术，并实现规模化应用。而公司产品目前仍以 SOP、SOT 等传统封装形式为主，先进封装产品占比相对较低。因此，公司若不能及时强化先进封装领域的产能布局，将难以匹配下游终端市场对先进封装的需求，可能导致核心竞争力弱化、市场份额被挤压，进而面临市场空间持续收窄的风险。基于此，公司优化产品结构，提高先进封装产品占比，是增强公司可持续发展能力的重要举措。本项目建设完成后，将有效提升公司 FC 等先进封装产品的产能布局，助力产品结构优化升级。

三、发行对象及其与公司的关系

（一）发行对象

发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35 名（含 35 名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（二）发行对象与公司的关系

截至本预案公告日，本次发行的发行对象尚未确定，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在发行竞价结束后公告披露发行对象与公司之间的关系。

四、本次发行股票方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出予以注册决定后 10 个工作日内完成发行缴款。

（三）发行对象及认购方式

本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35 名（含 35 名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或资本公积转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N 。

本次发行的最终发行价格将根据股东会授权，以竞价方式确定发行价格，并由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定，但不低于前述发行底价。

（五）发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股票的数量不超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为准。

（六）限售期安排

本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起六个月内不得转让。因公司送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（七）募集资金规模及用途

本次发行股票募集资金总额 11,000.00 万元（含本数），不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资额
1	高密度高性能芯片封测项目	19,812.39	11,000.00
合计		19,812.39	11,000.00

本次发行股票募集资金全部用于公司“高密度高性能芯片封测项目”建设。在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况

通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

（八）上市地点

本次发行的股票将在上交所科创板上市交易。

（九）本次发行前滚存未分配利润安排

公司在本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

（十）本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

若法律、行政法规、规范性文件以及部门规章对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的人民币普通股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后相关公告中予以披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

公司控股股东人为梁大钟先生，实际控制人为梁大钟、白瑛、梁华特。截至本预案公告日，梁大钟先生直接持有公司 40.24% 的股份，白瑛女士直接持有公

司 10.45%的股份，梁华特先生直接持有公司 5.49%的股份，三人合计持有公司 56.18%的股份。

本次发行完成后，公司股本将相应增加，梁大钟、白瑛、梁华特持有股份占公司总股本的比例将有所下降。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

七、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件

本次股票发行完成后，公司不存在股权分布不符合上市条件之情形。

八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

（一）本次发行已取得的授权和批准

2026 年 4 月 23 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的事宜。

根据 2025 年年度股东会的授权，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了本次发行方案及其他发行相关事宜。

（二）本次发行尚需获得的授权、批准和核准

- 1、本次发行竞价完成后，公司董事会审议通过本次发行的具体方案；
- 2、与本次发行相关的《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》等尚需经公司股东会审议通过；
- 3、本次以简易程序向特定对象发行股票尚需经上海证券交易所审核通过；
- 4、本次以简易程序向特定对象发行股票尚需经中国证监会作出同意注册的决定。

第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过 11,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后净额将用于公司主营业务相关项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资额
1	高密度高性能芯片封测项目	19,812.39	11,000.00
合计		19,812.39	11,000.00

本次发行股票募集资金全部用于公司“高密度高性能芯片封测项目”建设。在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析

（一）项目概况

高密度高性能芯片封测项目建设地点位于东莞市石排镇气派科技路 1 号，拟利用现有厂房并装修改造实施，并配备相应的生产设备，扩大公司封装测试产能。本项目建设完成后，公司将新增 QFN/DFN、DFN（第三代半导体）、FC-QFN/DFN、LQFP 等封装测试产能 5.14 亿只/年。项目的建设有利于进一步扩大公司产能，并优化公司产品结构，强化公司竞争力。

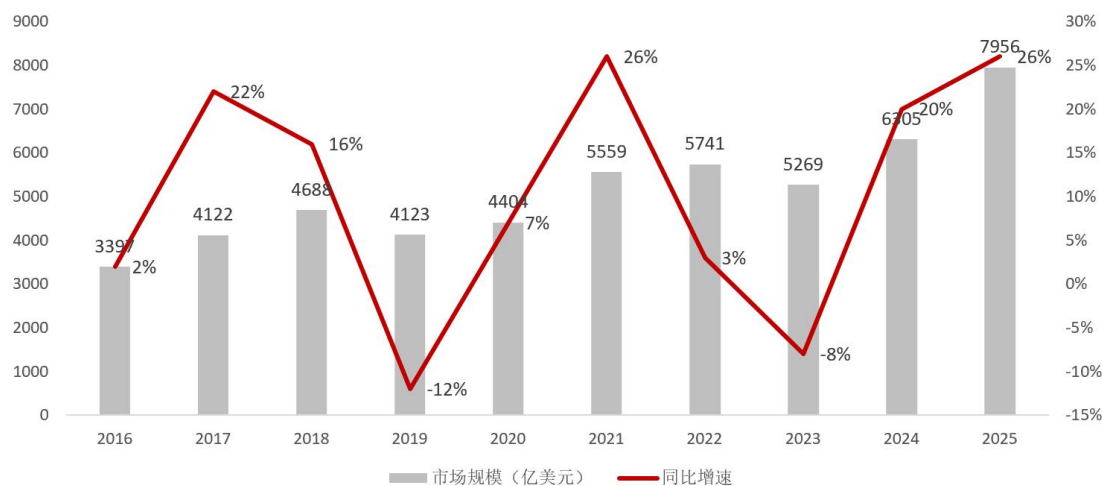
本项目计划投资总额 19,812.39 万元，其中，建设投资 19,575.37 万元，铺底流动资金 237.02 万元。

（二）募集资金投资项目的必要性分析

1、半导体行业需求持续攀升

近年来，5G 技术、物联网、新能源汽车及人工智能等新兴技术与终端产品加速迭代普及，直接带动全球半导体市场需求持续攀升，行业整体进入高速增长阶段。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2024 年全球半导体市场规模达到 6,305 亿美元，同比增长 20%，受到人工智能相关应用的推动以及计算和数据中心基础设施的持续需求驱动，2025 年全球半导体市场同比强劲增长 26%，达到 7,956 亿美元。

2016-2025 年全球半导体市场规模及增速



数据来源：WSTS

半导体市场规模的持续增长带动集成电路封测市场需求持续攀升，根据 Yole 的相关数据，2014 年至 2024 年，全球半导体封装测试市场销售额由 532 亿美元增长至 899 亿美元。未来，全球半导体封装测试技术将继续向小型化、集成化、低功耗方向发展，在新兴市场和半导体技术进步的共同带动下，附加值更高的先进封装将得到越来越多的应用，封装测试业市场有望持续向好，2026 年全球封测市场规模将有望达 961 亿美元。

2014-2024 年全球半导体封装测试市场销售额及增长情况



数据来源：Yole

2、突破产能瓶颈，满足下游市场需求

公司深耕半导体封装测试领域多年，已发展成为华南地区规模领先的内资封装测试企业之一。近年来，公司业务规模稳步扩张，产能利用率持续攀升。2023年至2025年，公司封装测试产量分别为89.74亿只、107.98亿只、125.38亿只，对应收入分别为5.20亿元、6.24亿元、7.29亿元，增速分别为19.91%和16.83%，封装测试产品和收入均保持较快增长。2023年至2025年，公司封装测试产能利用率分别为68.13%、80.57%、88.52%，2025年全年处于高负荷运行状态。公司现有产能接近饱和已成为制约订单承接与业务扩张的重要因素。若无法及时扩充产能，公司将面临订单交付延迟、客户流失等风险，错失行业发展机遇，进而影响营收规模扩大与市场份额提升。

本次扩产项目公司产品系DFN/QFN等系列的中高端产品，应用领域包括人工智能、物联网、智能家居、消费电子等高景气高需求行业，可有效释放产能瓶颈，满足下游市场需求，提升公司可持续发展能力。

3、布局FC先进封装形式产品，优化产品结构，提升公司在先进封装测试领域的竞争力

近年来，集成电路终端系统向多任务处理、微型化方向加速演进，持续驱动封装技术向高性能、高密度、高散热、晶圆级、薄型化及小型化迭代升级。在此背景下，FC、SiP、TSV等先进封装技术的应用场景不断拓展，已成为行业重要

发展方向。

当前，日月光、安靠、长电科技、华天科技、通富微电等国内外领先企业均已较全面地掌握 FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV、Chiplet 等先进封装技术，并实现规模化应用。而公司产品目前仍以 SOP、SOT 等传统封装形式为主，先进封装产品占比相对较低。因此，公司若不能及时强化先进封装领域的产能布局，将难以匹配下游终端市场对先进封装的需求，可能导致核心竞争力弱化、市场份额被挤压，进而面临市场空间持续收窄的风险。基于此，公司优化产品结构，提高先进封装产品占比，是增强公司可持续发展能力的重要举措。本项目建设完成后，将有效提升公司 FC 等先进封装产品的产能布局，助力产品结构优化升级，提升公司在先进封装测试领域的竞争力。

4、扩大经营规模，巩固和提升行业竞争地位

当前，国内封装测试市场竞争格局日趋激烈，长电科技、通富微电、华天科技等内资领先企业不仅通过资本市场募集资金扩充产能、进行技术和产品升级，还通过市场化收购兼并实现资源整合与跨越式发展，不断筑牢竞争优势。与此同时，各类外资及合资封测企业也持续加大在中国大陆的产能布局与资金投入，进一步加剧了国内市场的竞争烈度，行业头部集聚效应愈发明显。

公司经过在封测领域多年的积累和拓展，目前已具备一定规模和较强技术实力，但与长电科技、通富微电和华天科技等为典型代表的中国大陆封装测试行业龙头企业相比，仍有较大的提升空间。在当前市场高速发展的态势下，公司如若不能及时扩大自身规模、增强竞争实力，将可能面临市场份额被挤压、客户资源流失的风险。特别是随着下游客户对供应链稳定性和交付能力的要求不断提高，产能规模已成为客户选择封测供应商的重要考量因素。因此，通过本项目建设扩大生产规模，是公司巩固和提升市场竞争地位的必然选择。

（三）募集资金投资项目的可行性分析

1、本项目产品具有广阔的市场前景

半导体封测产业与半导体产业景气状况紧密相关，随着半导体景气度全面复苏以及人工智能、数据中心、云计算、物联网、虚拟/增强现实等新兴应用场景的

快速发展，全球半导体产业景气度高涨带动半导体封测市场规模持续扩张。根据 Yole 的相关数据，2014-2024 年，集成电路封装测试全球市场规模由 532 亿美元增长至 899 亿美元，复合年增长率（CAGR）达到 5.4%。

根据中国半导体行业协会的数据，从中国大陆市场来看，受益于产业政策支持与下游需求带动，2017-2024 年中国大陆封测市场规模由 1,889.7 亿元增长至 3,336.8 亿元，复合增长率为 8.5%；未来随着全球集成电路产业重心向中国大陆转移，行业将保持稳定增长态势。

综上所述，半导体封测产业广阔的市场空间是本项目的建设基础，项目产品符合行业发展趋势和市场需求，具有良好的市场前景。

2、公司具备的生产组织与质量管理优势为项目产品提供基础保障

封装工艺的功能包括功率分配（电源分配）、信号分配、散热通道、隔离保护和机械支持等，每一项功能都能影响芯片的性能，封装技术的好坏还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的 PCB（印制电路板）的设计和制造。因此，良好的生产组织与量管控能力，是封测企业重要的竞争力之一。

公司深耕半导体封测领域多年，积累了丰富的产品矩阵与工艺经验，封装产品覆盖 MEMS、FC、CPC、SOP 等多种系列。公司自成立伊始便坚持提升生产管理与质量管理水平，打造了一支经验丰富的研发技术团队和高素质生产管理人才队伍。在生产组织方面，公司依托成熟的生产经验与稳定可靠的技术工艺，采用柔性化生产模式，可根据客户订单需求灵活调整生产计划与产品结构，快速完成生产线调试与组合，实现高效率、多批次、小批量的柔性生产，显著提升市场快速响应能力。此外，公司建立并严格执行全流程质量管理体系，不断完善作业规范、质量控制及工艺管理制度，已通过 ISO9001:2015 质量管理体系、IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系及 ISO22301 业务连续性管理体系认证等，为产品质量稳定与持续经营提供坚实保障。

3、公司具备的技术和人才优势为项目提供技术基础

本次募投项目产品均已正式量产或小批量试生产，募投项目实施具备技术基

础。

半导体封装测试行业属于技术密集型与人才密集型行业，管理团队与核心技术团队是企业持续技术创新、保持核心竞争力的关键要素。封装测试企业需要能够将理论研究与实际生产相结合的专业性人才，才能更好地提升公司的技术水平、研发能力和生产管理能力和，保证生产效率、产品成本与质量、交货期的稳定性，形成竞争优势。

公司专注于半导体封装测试领域，经过多年技术积累与市场深耕，已发展成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，也是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。在人才方面，公司核心技术人员具备多年半导体封测行业从业经验，研发团队熟练掌握半导体封装特性及封装测试生产流程关键技术，有效保障公司产品在质量稳定性、成本控制、规模化交付等方面形成核心竞争优势。目前公司已掌握了 5G 基站 GaN 射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、FC 封装技术、MEMS 封装技术、大功率碳化硅芯片塑封封装技术等多项核心技术，形成了自身在半导体封装测试领域的竞争优势，在半导体封装测试领域具有较强的竞争实力。

综上，公司具有的技术和人才优势助力公司在国内半导体封测领域构建较强的综合竞争实力，为项目顺利实施奠定了扎实的技术和人才基础。

4、项目概算

本项目总投资 19,812.39 万元，具体构成情况如下：

序号	费用名称	投资金额（万元）	占总投资比例
1	建设投资	19,575.37	98.80%
1.1	建筑工程费	660.00	3.33%
1.1.1	装修工程费	660.00	3.33%
1.2	设备购置及安装费	17,983.21	90.77%
1.3	预备费	932.16	4.70%
2	铺底流动资金	237.02	1.20%

序号	费用名称	投资金额（万元）	占总投资比例
3	项目总投资	19,812.39	100.00%

5、项目实施主体、建设地点、建设周期

本募投项目实施主体为广东气派科技有限公司，项目建设地点位于广东省东莞市石排镇气派科技路1号，项目建设期为3年。

6、项目备案与环境保护评估情况

本项目拟利用现有土地和厂房。截至本预案公告日，本项目备案手续和相关环评手续正在办理中。

7、项目的效益分析

经过可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。项目实施后，能够为公司带来稳定的现金流入。

三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司发展战略，顺应行业发展趋势，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施，有利于进一步提升公司产品能力，巩固和发展公司的市场竞争力，实现公司的长期可持续发展。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长。同时，公司资产负债率将相应下降，公司的资产结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。

四、总结

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次以简易程序向特定对象发行股票可以提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构 **和业务结构的变化情况**

(一) 本次发行对公司业务及资产的影响

公司主营业务为半导体封装测试，主要产品有 MEMS、FC、5G 氮化镓射频器件塑封封装、LQFP、QFN/DFN、CQFN/CDFN、CPC、SOP、SOT、TO、DIP、PDFN 等多个系列产品共计超过 300 种封装形式。经过多年的沉淀和积累，公司已发展成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目扣除相关发行费用后将用于建设“高密度高性能芯片封测项目”，符合公司的业务发展方向和战略布局。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，公司中高端产品产能和占比提升，不涉及对公司现有资产的整合，不会对公司的业务及资产产生重大影响。

(二) 本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司的股本总额将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。除此之外，本次发行完成后，公司章程的其他条款不存在因本次发行而受到影响的情形。

(三) 本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布仍符合上市条件。

(四) 本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不涉及对公司高级管理人员结构的调整。截至本预案公告日，公司

无对高管人员结构进行重大调整的计划。若公司未来拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对业务结构的影响

本次募集资金投资项目系围绕公司现有主营业务，随着募投项目的实施，公司中高端封装测试产品的产能和收入占比提升，有利于公司提升核心竞争力，本次发行后公司业务不会发生重大变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模将同时增加，公司的资产负债率将有所降低，公司整体财务状况将得到一定程度的提高，财务结构趋向优化，有利于增强公司抵御财务风险的能力，提升公司盈利能力，增强公司的综合竞争力。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司的总股本及净资产规模有所增加，但募集资金投资项目实施并产生效益需要一定周期，因此本次发行募集资金到位后短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降。

但本次募集资金投资项目系围绕公司现有主营业务，综合考虑市场需求及发展战略而选择实施，长期来看有助于公司提升核心竞争能力，提升未来公司经营业绩和盈利能力。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行后，随着募集资金的到位，公司筹资活动产生的现金流入将增加；随着募集资金投资项目的实施及效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加；随着公司盈利能力和经营状况的改善，公司整体现金流状况将得到进一步优化。

三、本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、

管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化的情形，也不会因本次发行形成同业竞争。公司将严格按照中国证监会、上交所关于上市公司关联交易的规章、规则和政策，确保上市公司依法运作，保护上市公司及其他股东权益不会因此而受影响。本次发行将严格按照规定程序由上市公司董事会、股东会进行审议，履行真实、准确、完整、及时的信息披露义务。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

本次发行完成后，公司的资产负债率将有所下降，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。公司的资产负债结构将更趋合理，抵御风险能力将进一步增强，符合公司全体股东的利益。

第四节 本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时，除本预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

一、市场和行业风险

（一）宏观经济及下游相关行业需求变化的风险

公司主营业务为半导体封装测试，半导体行业的发展状况对公司的生产经营具有重大直接影响。半导体行业具有与宏观经济同步的特征，其波动幅度甚至会超过全球经济波动幅度。若未来宏观经济形势变化，全球半导体产业市场出现较大波动，将对公司经营业务和经营业绩带来较大的影响。

同时，公司下游消费电子行业产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌及规格型号繁多等特点，消费者对不同品牌、不同产品的偏好变化速度快，不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期短于其他传统行业。如果公司未来不能快速响应终端市场的需求变化，或公司主要客户对应产品在终端市场竞争中处于不利地位，公司现有市场规模将难以保持甚至出现萎缩，进而对公司经营业绩造成不利影响。

（二）半导体行业周期性波动的风险

半导体行业具有较强的周期性，全球半导体行业在技术驱动和宏观经济的影响下呈周期性波动。报告期内，伴随着 5G 应用、物联网、消费电子、人工智能、大数据、自动驾驶、电动汽车等下游应用领域的普及和发展，半导体行业出现了一波上升周期。但与此同时，宏观经济波动、半导体下游行业产品生命周期变化、半导体产业技术升级、终端消费者消费习惯变化均可能导致半导体周期转换。

未来，若半导体行业出现周期性波动，或出现下游需求规模锐减等不利情形，半导体封装测试企业有可能订单减少及盈利能力下降等问题，从而对公司的经营水平带来一定不利影响。

（三）市场竞争加剧的风险

公司主要从事半导体封装、测试业务。经过多年的沉淀和积累，公司已发展

成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。但随着客户对半导体封装、测试的需求不断增长，一方面，长电科技、通富微电、华天科技、盛合晶微等内资领先企业不仅通过资本市场募集资金增加生产线、进行技术和产品的升级改造以提升产品产能、质量和技术水平，还通过收购兼并的方式实现了产能的大幅提升和技术的升级迭代。另一方面，外资和合资封装测试企业进一步布局中国大陆，加大了资金和资源的投入。

因此，公司作为国内半导体封装测试第二梯队企业，相关产品不仅面临国内、国际同行业企业的激烈竞争，还面临行业潜在或新进入者的竞争威胁。如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，将可能导致公司产品市场竞争力下降，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

二、财务风险

（一）净利润持续为负的风险

报告期内，公司净利润分别为-13,099.99 万元、-10,579.91 万元、-8,178.64 万元和-478.26 万元，受到以消费电子为代表的下游行业需求变动的的影响，报告期内公司业绩连续亏损，但亏损持续收窄。虽然本次向特定对象发行股票的募集资金预计将有利于改善公司经营和财务状况，但是公司仍然存在因行业持续低迷或经营不当导致净利润持续为负的风险。

（二）毛利率波动风险

公司主要从事半导体封装测试业务，经营业绩及整体毛利率水平会随着终端产品市场的波动而出现较大变化。报告期内，公司主营业务收入分别为52,133.82 万元、62,700.12 万元、73,634.44 万元和21,393.45 万元，主营业务毛利率分别为-17.43%、-5.94%、2.44%和7.31%。

公司产品的毛利率水平主要受所处行业情况、市场供求关系、产品生产难度、公司销售及市场策略、折旧摊销及材料人力成本等因素综合影响而波动。未来若市场竞争的加剧、竞争者的数量增多及技术服务的升级导致公司调整产品及服务

的定位、降低产品及服务的价格，或行业终端需求不足，公司产能利用率下降，折旧摊销及人力成本等固定支出对毛利率的影响放大，公司产品毛利率水平存在较大幅度波动的风险，从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

（三）应收账款发生坏账风险

公司报告期各期末应收账款净额分别为10,971.03万元、12,082.10万元、15,511.96万元和16,009.44万元，占当期流动资产的比例分别为31.56%、29.56%、33.58%和32.83%，占比较高。报告期内，公司应收账款账龄整体较短，账龄1年以内应收账款占应收账款余额的比例均在94%以上；公司建立了相应的应收账款管理制度加强应收账款的回收管理，应收账款实际发生坏账的风险较小。

未来随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果客户经营情况恶化，出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。

（四）存货跌价损失的风险

报告期各期末，公司存货账面净额分别为10,309.70万元、11,860.88万元、13,484.59万元和14,814.21万元，占当期流动资产的比例分别为29.66%、29.02%、29.19%和30.38%，存货占流动资产的比例较高。尽管公司的生产模式主要为以销定产的定制化生产模式，即根据客户订单的要求，按照客户提供的产品规格、质量要求和供货时间组织生产；但公司报告期末存货余额较大，若下游客户存在重大延期或违约，公司将承担存货跌价的风险。

（五）净资产收益率和每股收益被摊薄的风险

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，特此提醒投资者关注本次以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报的风险，同时提示投资者，公司虽然为此制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

三、经营风险

（一）生产效率下降风险

半导体封装测试行业的生产模式最主要的特点是多批次、多品种，如何通过合理、有效的管理和组织调度，生产出符合客户要求的产品，同时满足客户快速交货的需求是企业核心竞争力的重要体现。

随着公司生产规模的不断扩大、工艺流程的日益复杂，如果公司未来不能在管理方式上及时创新，生产人员技术水平及熟练程度无法保持或者持续提升，公司将会面临生产效率下降的风险。生产效率下滑将导致公司生产规模无法保持或持续扩大，不仅会使产品交期延长、竞争力削弱及客户流失，同时还会使公司无法保持在成本控制方面的优势，将会对公司经营业绩产生不利影响。

（二）核心技术人员流失的风险

公司自成立以来一直从事半导体封装测试业务，所处行业为资金、资产、技术、管理和人才密集型行业，优秀的研发技术人员是公司赖以生存和发展的基础，是公司获得和保持持续竞争优势的关键。随着半导体封装测试市场竞争的不断加剧及新的参与者加入，企业之间对人才尤其是优秀研发技术人员的争夺将更加激烈，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇、设立具备较强吸引力的激励考核机制，公司将难以持续引进并留住优秀研发技术人员，公司将可能面临研发技术人员流失的风险；如果出现研发技术人员流失，公司还将面临技术泄密的风险。

（三）经营规模扩张带来的管理风险

随着公司总体经营规模进一步扩大，公司的资产规模、生产规模、销售规模等都将增加，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。公司通过多年的持续发展，已建立起与公司业务相匹配的经营管理体系，但如果公司管理层不能持续有效地提升管理能力、优化管理体系，将导致公司管理体系不能完全适应公司业务规模的快速发展，公司将存在一定的经营管理风险，对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。

（四）技术风险

半导体封测技术需要紧跟市场需求，芯片设计、晶圆制造等领域的技术进步及下游对于小型化、低功耗器件持续增长的需求，对封测技术研发不断提出新要求。若公司未来的技术研发方向不能顺应市场封装技术的变化及不断提高的工艺标准，公司将面临无法持续满足下游领域对于产品技术升级的需求，技术研发压力较大，研发投入无法取得预期效果，对公司未来经营业绩将造成不利影响。

（五）房屋及土地已抵押的风险

广东气派将其拥有的 66,670.10 平方米国有土地使用权及其上的全部房产（粤[2017]东莞不动产权第 0119369 号、粤[2017]东莞不动产权第 0119366 号等 9 项）抵押给中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行（一押）和中国银行股份有限公司东莞分行（二押）。如果未来公司生产经营出现重大不利变化导致资金链断裂而造成贷款违约，公司将面临被债权人主张担保债权而导致该土地使用权及房产被折价抵偿或拍卖、变卖的风险。

四、审批与发行风险

本次股票发行方案已经公司董事会批准，尚需上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。本次发行能否获得相关审批机构的批准以及最终获得批准的时间均存在不确定性。

第五节 利润分配政策及执行情况

一、公司利润分配政策

现行《公司章程》中公司利润分配政策如下：

（一）利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配的形式和期间间隔

公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，但应当优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

在具备利润分配的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配。经董事会和股东会审议决定，公司可以进行中期利润分配。

（三）利润分配的具体内容和条件

公司进行现金分红应同时具备以下条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告；3、公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等特殊情形发生。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%或超过 5,000 万元。

当公司发生以下情形的，可以不进行利润分配：（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持相关的重大不确定性段落的无保留意见；（2）资产负债率高于 70%；（3）经营性现金流为负。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资

金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第（3）项规定处理。

在具备现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供现金分配利润的 20%，且在任何 3 个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。公司采取股票方式分配股利的条件为：1、公司经营情况良好；2、因公司股票价格与公司股本规模不匹配或者公司有重大投资计划或重大现金支出、公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，以股票方式分配股利有利于公司和股东的整体利益；3、公司的现金分红符合有关法律法规及公司章程的规定。

（四）利润分配政策及其调整的决策程序和机制

公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和公司章程的规定制订合理的利润分配方案并经董事会审议通过后提请股东会审议，审计委员会应对提请股东会审议的利润分配方案进行审核并出具书面意见。董事会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决同意。审计委员会在审议利润分配方案时，须经全体成员过半数表决同意。股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征求中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、传真、邮件或者投资者交流平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东可在审议利润分配方案的股东会召开

前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，其中，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

公司应当严格执行有关法律、法规、规范性文件及公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。在遇到自然灾害等不可抗力事件或者因公司外部经营环境发生较大变化等特殊情况出现，并已经或即将对公司生产经营造成重大不利影响的，公司经详细论证后可以调整既定利润分配政策。公司对既定利润分配政策（尤其是现金分红政策）作出调整时，应详细论证调整利润分配政策的必要性、可行性，充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。调整后的利润分配政策应符合有关法律、法规的规定，经董事会审议通过后须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司在有关法律、法规、规范性文件允许或公司章程规定的特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因、留存未分配利润的用途以及独立董事的明确意见，公司当年的利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且公司在将该利润分配议案提交股东大会审议时应为投资者提供网络投票便利条件。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

二、公司近三年股利分配情况

（一）公司近三年利润分配情况

公司于 2024 年 6 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于公司 2023 年度亏损，公司不进行

现金分红，也不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于公司 2024 年度亏损，公司不进行现金分红，也不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了 2025 年年度股东会，审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，鉴于公司 2025 年度亏损，公司不进行现金分红，也不送红股、不进行资本公积金转增股本。

（二）公司最近三年现金股利分配情况

公司最近三年未进行现金分红。

（三）公司近三年未分配利润使用情况

最近三年，公司滚存未分配利润主要用于公司的日常经营和补充流动资金，以支持公司业务发展和发展战略的落实。

三、公司未来三年股东分红回报规划

随着公司的成长及发展，为给予投资者合理的投资回报，进一步强化回报股东的意识，充分维护股东依法享有的收益权，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公司章程等相关规定制定了公司未来三年股东分红（2026 年-2028 年）回报规划，具体内容如下：

（一）制定分红回报规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展的实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，细化分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）制定分红回报规划的原则

1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，并兼顾公司的可持续发展。

2、公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，但应当优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

3、在具备利润分配的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配。经董事会和股东会审议决定，公司可以进行中期利润分配。

（三）分红回报规划的具体内容

1、现金分红的条件

公司实施现金分红应同时满足以下条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后利润）为正值。

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。

（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等特殊状况发生。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%或超过 5,000 万元。

2、现金分红的比例和间隔

在具备现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供现金分配利润的 20%，且在任何 3 个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第（3）项规定处理。

3、发放股票股利的条件

(1) 公司经营情况良好；

(2) 因公司股票价格与公司股本规模不匹配或者公司有重大投资计划或重大现金支出、公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，以股票方式分配股利有利于公司和股东的整体利益；

(3) 公司的现金分红符合有关法律法规及公司章程的规定。

(四) 利润分配政策的决策机制和程序

1、公司利润分配方案的制定及决策机制

(1) 公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和公司章程的规定制订合理的利润分配方案并经董事会审议通过后提请股东会审议，审计委员会应对提请股东会审议的利润分配方案进行审核并出具书面意见。董事会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决同意。审计委员会在审议利润分配方案时，须经全体成员过半数表决同意。股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(2) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征求中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、传真、邮件或者投资者交流平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公

司董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东可在审议利润分配方案的股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权，其中，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

(3) 公司在有关法律、法规、规范性文件允许或公司章程规定的特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因、留存未分配利润的用途以及独立董事的明确意见，公司当年的利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且公司在将该利润分配议案提交股东会审议时应为投资者提供网络投票便利条件。

2、公司利润分配政策的调整程序

公司应当严格执行有关法律、法规、规范性文件及公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。在遇到自然灾害等不可抗力事件或者因公司外部经营环境发生较大变化等特殊情况出现，并已经或即将对公司生产经营造成重大不利影响的，公司经详细论证后可以对既定利润分配政策作出调整。公司对既定利润分配政策（尤其是现金分红政策）作出调整时，应详细论证调整利润分配政策的必要性、可行性，充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。调整后的利润分配政策应符合有关法律、法规的规定，经董事会审议通过后须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第六节 本次以简易程序发行股票摊薄即期回报分析

根据 2025 年年度股东大会的授权，公司拟以简易程序向特定对象发行股票。本次发行完成后，由于募集资金投资项目拟达到的预期收益需逐步释放，预计短期内公司每股收益（包括扣除非经常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公司就本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析，并就填补回报拟采取的应对措施进行了明确，公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员出具了关于填补被摊薄即期回报的承诺，具体情况如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算

（一）测算假设及前提

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2026 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次发行于 2026 年 9 月 30 日前实施完毕，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成公司对实际完成时间的承诺。最终以中国证监会同意本次发行注册后的实际完成时间为准。

3、假设本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为 11,000.00 万元，暂不考虑相关发行费用，假设本次以简易程序向特定对象发行股票的价格为 22.71 元/股（该价格为公司股票于 2026 年 4 月 27 日前二十个交易日交易均价的

80%，该价格仅为模拟测算价格），则本次以简易程序向特定对象发行股票 484.37 万股，该数量仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准。

4、本次发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

5、本次测算不考虑本次发行募集资金到位、其他非经常性损益、不可抗力因素等对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）、股本等的影响。

6、以 2025 年度测算，公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为-7,538.40 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,657.72 万元。假设公司 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在 2025 年基础上按照持平、增亏 20%、减亏 20%等三种情景分别计算。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下，本次以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日	2026 年度/2026 年 12 月 31 日	
		发行前	发行后
总股本（万股）	10,687.98	11,477.98	11,932.35
本次募集资金总额（万元）		11,000.00	
本次发行股份数量（万股）		484.37	
1、2026 年扣非前后归属于母公司股东的净利润较 2025 年持平			
归属于母公司股东的净利润（万元）	-7,538.40	-7,538.40	-7,538.40
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-8,657.72	-8,657.72	-8,657.72
基本每股收益（元/股）	-0.71	-0.67	-0.65
稀释每股收益（元/股）	-0.71	-0.67	-0.65
扣除非经常损益后基本每股收益（元）	-0.81	-0.77	-0.75
扣除非经常损益后稀释每股收益（元）	-0.81	-0.77	-0.75
2、2026 年扣非前后归属于母公司股东的净利润较 2025 年增亏 20%			

归属于母公司股东的净利润（万元）	-7,538.40	-9,046.08	-9,046.08
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-8,657.72	-10,389.26	-10,389.26
基本每股收益（元/股）	-0.71	-0.81	-0.78
稀释每股收益（元/股）	-0.71	-0.81	-0.78
扣除非经常损益后基本每股收益（元）	-0.81	-0.93	-0.90
扣除非经常损益后稀释每股收益（元）	-0.81	-0.93	-0.90
3、2026 年扣非前后归属于母公司股东的净利润较 2025 年减亏 20%			
归属于母公司股东的净利润（万元）	-7,538.40	-6,030.72	-6,030.72
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-8,657.72	-6,926.17	-6,926.17
基本每股收益（元/股）	-0.71	-0.54	-0.52
稀释每股收益（元/股）	-0.71	-0.54	-0.52
扣除非经常损益后基本每股收益（元）	-0.81	-0.62	-0.6
扣除非经常损益后稀释每股收益（元）	-0.81	-0.62	-0.6

注：每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会公告〔2010〕2 号）的有关规定计算。

二、对于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，由于公司的股本总额会有所增加，若公司的利润在短期内不能得到相应幅度的增加，则预计公司每股收益（包括扣除非经常性损益后的每股收益、净资产收益率等财务指标）将受到影响，公司股东即期回报存在被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次发行融资符合公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，有利于优化公司产品结构，提升公司竞争实力。本次发行有利于增强公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次募集资金的必要性和合理性分析，参见本预案“第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析”之“二、本次

募集资金投资项目的基本情况及可行性分析”相关内容。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主营业务为半导体封装测试，主要产品有 MEMS、FC、5G 氮化镓射频器件塑封封装、LQFP、QFN/DFN、CQFN/CDFN、CPC、SOP、SOT、TO、DIP、PDFN 等多个系列产品共计超过 300 种封装形式。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目扣除相关发行费用后将用于“高密度高性能芯片封测项目”建设，符合公司的业务发展方向和战略布局。本次募集资金投资项目的顺利实施，将充分发挥公司现有核心技术、客户资源等优势，有利于进一步提升公司中高端产品产能、技术储备和产品性能，巩固和发展公司的市场竞争力，实现公司的长期可持续发展。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、公司从事募集资金投资项目在人员方面的储备情况

气派科技的多数高级管理人员及部分核心技术人员拥有 20 年以上集成电路技术研发或管理经验，具备国际领先企业的行业视野或国内一流企业的从业经验，是一支经验丰富、结构合理、优势互补的核心团队，为持续提升公司核心竞争力、设计新产品、开发新工艺提供强有力的人力资源支持。截至 2026 年 3 月 31 日，公司拥有研发技术人员 195 人，占员工总人数的 10.82%。

公司不仅在研发人员及管理团队中具备人才优势，也将人才优势进一步推广到生产一线，为近年来公司精益生产线优化设计技术的深层次应用奠定了人力资源基础。

2、公司从事募集资金投资项目在技术方面的储备情况

半导体封装测试属于技术密集型行业，行业创新主要体现为生产工艺的创新，技术水平主要体现为产品封装加工的工艺水平。气派科技通过近十六年的技术研

发积累与沉淀，现已形成了 5G 基站 GaN 射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、小型化有引脚自主设计的封装方案、封装结构定制化设计技术、FC 封装技术、MEMS 封装技术、大功率碳化硅芯片塑封封装技术、基于铜夹互联的大功率硅芯片封装技术等核心技术，推出了自主定义的 CQFN/CDFN、CPC 和 Qipai 等封装系列产品，对贴片系列产品予以了优化升级等。

近年来，公司及其全资子公司广东气派在半导体封装测试领域持续获得各级政府及行业组织的认可。2019 年 12 月，公司自主定义的“CPC 封装技术产品”被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。2020 年 8 月，中国半导体行业协会等将公司“CPC 封装技术产品”评选为“中国半导体创新产品和技术”。2020 年 12 月，广东气派被国家工信部评为第二批专精特新“小巨人”企业。2021 年 3 月，公司“5G 基站用氮化镓（GaN）分立式射频器件”被广东省高新技术企业协会评选为“2020 年广东省名优高新技术产品”。2022 年 5 月，公司被广东省工业和信息化厅评为“广东省省级企业技术中心”。2022 年 8 月，广东气派投资建设的第三代半导体芯片封装测试重点实验室被认定为“东莞市第三代半导体芯片封装测试重点实验室”。2022 年 12 月，广东气派通过广东省知识产权保护协议“2022 年度广东省知识产权示范企业”认定。2023 年 10 月，公司被工业和信息化部评为“2023 年度智能制造优秀场景”。2024 年 9 月，广东省工业和信息化厅将公司“5G 宏基站大功率 GaN 射频功放的塑封封装技术服务”评选为“广东省制造业单项冠军企业”。

公司自身的技术研发实力不断提升，已具备封装测试领域的技术研发优势，研发优势不断转化为研发成果，未来将进一步提升现有核心业务的技术水平，开发出更具竞争力的封装测试产品，巩固和扩大自身的竞争优势。

3、公司从事募集资金投资项目在市场方面的储备情况

公司具备较为齐全的封装测试产品类别及良好的供货能力，地理位置位于粤港澳大湾区，贴近客户应用市场。发行人品牌在封装测试行业内特别是在华南区域内具有一定的知名度，以兆易创新、普冉半导体、思瑞浦、上海贝岭、矽力杰、华润微、华微电子、昂宝电子、晟矽微电、成都蕊源等为代表的境内外芯片企业已与发行人建立起直接或间接的合作关系，未来，公司将在与前述客户保持紧密

合作的基础上,大力拓展新的功率半导体的客户,进一步提升公司的品牌知名度。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为促进业务健康、良好的发展,充分保护本公司股东特别是中小股东的权益,本公司将采取如下具体措施提高日常运营效率,降低运营成本,增强公司的可持续发展能力,提升本公司的业务规模、经营效益,为中长期的股东价值回报提供保障。

（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

公司已根据《公司法》《证券法》和《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度,以便于募集资金的管理和使用,并对其使用情况加以监督。公司将定期检查募集资金使用情况,保证募集资金专款专用,确保募集资金按照既定用途得到有效使用。

（二）加快主营业务的拓展，提高公司的持续盈利能力

经过多年的沉淀和积累,公司已发展成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一,是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。本次发行将进一步推进公司主营业务的发展,提高公司的竞争优势、改善公司的资产质量,使公司的资金实力进一步提高,实现公司的稳步健康发展,对公司的生产经营具有积极意义。同时,公司将进一步提高核心技术产品的研发投入并扩大市场竞争优势,提升公司的研发和创新能力,进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。本次发行募集资金到位后,公司将科学统筹资金使用,切实提高资金使用效率,助力公司实现稳健发展,从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

（三）进一步优化经营管理和提升经营效率

本次发行募集资金到位后,公司将继续着力提高内部运营管理水平,提高资金使用效率,完善投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,控制资金成本,提升资金使用效率,加强费用控制,全面有效地控制公司的经营风险。同时,公

公司将持续推动人才发展体系建设，优化激励机制，最大限度地激发和调动员工积极性，提升公司的运营效率、降低成本，提升公司的经营业绩。

（四）完善利润分配政策，重视投资者回报

为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将严格执行利润分配规定，切实保障投资者合法权益。

六、公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺

（一）控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺

为确保公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东与实际控制人梁大钟、公司实际控制人白瑛、梁华特承诺如下：

“1、不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的

有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

（二）董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺

为确保公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司董事、高级管理人员承诺如下：

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

7、本承诺出具日后至本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

气派科技股份有限公司

2026 年 4 月 28 日